

PUBLIKATIONEN VON PROF. DR. PETER KERSTEN

Stand: 10/2015

- P. Kersten, H. Reichl, "Integration of Thin Film Polyimide with PCB Technology", Circuit World, Vol. 19, No. 4, 16 - 17 (1993).
- P. Kersten, W. Budweiser, H. Reichl, "Dünnschichttechnik auf Leiterplattenlaminaten", productronic, 10/93, 80 - 82 (1993).
- P. Kersten, V. Glaw, H. Reichl, "Excimer Laser Structuring of Epoxy Resin Layers for MCM-L Applications", Circuit World, Vol. 20, No. 1, 20 - 22 (1993).
- P. Kersten, "Feinstleitertechnik auf Leiterplatten", Workshop Entwurf und Technologien von Multi-Chip-Modulen, Technische Universität Berlin (1993).
- P. Kersten, V. Glaw, H. Reichl, "Excimerlaser - Bearbeitung von Epoxidharzschichten für MCM-L Anwendungen", productronic, 1/2 94, 40 (1994).
- P. Kersten, G.K.H. Schammler, H. Reichl, "An Additive Approach to Multichip Modules Using Electroless Metallization Processes", The International Journal of Microcircuits & Electronic Packaging, Vol. 17, No.1, 73 - 79 (1994).
- P. Kersten, "Entwurf von Multichip Modulen" und "Verdrahtungssysteme auf der Basis von Leiterplattenlaminaten", eingeladener Vortrag bei der Hewlett-Packard GmbH, Böblingen (1994).
- P. Kersten, "Entwicklung eines Dünnschichtverdrahtungssystems auf der Basis von Leiterplattenlaminaten", Dissertation TU-Berlin, Shaker Verlag, Aachen (1995).
- P. Kersten, S. Bouwstra and J.W. Petersen, "Photolithography on 3D surfaces using electrodeposited photoresists", Sensors and Actuators A 51, 51 - 54 (1995).
- C. Christensen, P. Kersten, S. Henke and S. Bouwstra, "Wafer Through-Hole Interconnections with High Vertical Wiring Densities", IEEE CPMT A, Vol. 19, No. 4, 516 - 522 (1996).
- P. Kersten, "High density substrates for FC and BGA mounting", conference on printed circuit board technology organized by the Fraunhofer-Institute IZM Berlin and the German chapter of IEEE-CPMT, Berlin, January 27-29 (1997).
- P. Kersten, "Warum sind Sacklöcher wichtig ? Erfahrungsbericht über 5 Milliarden gebohrte und galvanisierte Sacklöcher", productronic September 97 (1997).

PUBLIKATIONEN VON PROF. DR. PETER KERSTEN

Stand: 10/2015

- P. Kersten, "Why are blind vias important - Report on the experience gained with over 5 billion drilled and plated vias", Printed Circuit Europe, 21-24, No. 4 July-August (1997).
- P. Kersten, "Substratbumping für die Flip-Chip Bestückung", F&M Zeitschrift für Elektronik, Optik und Mikrosystemtechnik, März 98 (1998).
- P. Kersten, "Substrate bumping for Flip Chip assembly", Printed Circuit Europe, No. 8 March-April (1998).
- P. Kersten, "Hochdichte Leiterplatten und die Möglichkeiten für den Schaltungsentwickler", F&M Zeitschrift für Elektronik, Optik und Mikrosystemtechnik, November/98 (1998).
- S. Albrecht, P. Kersten, "Plugging: Ein Schlüsselprozess in der Micro Via Technologie", productronic (1999)
- S. Albrecht, P. Kersten, "Benefits of Hole Plugging for Micro Via Printed Circuit Boards", CircuitTree, September (1999)
- P. Kersten, "Mikrovia Leiterplatten für höchste Verdrahtungsdichten", OTTI Technik Kolleg, Erstes Fachforum Mechatronik am 25. und 26. Oktober (2000).
- P. Kersten, "Mikrovia Leiterplatten für höchste Verdrahtungsdichten", Internationaler Fachkongress Leiterplatten für die UMTS- und HDI/SBU Technologie am 07. und 08. Dezember (2000).
- P. Kersten, "Hochdichte Elektronik, blei- und halogenfrei gefertigt: Anforderungen und Konsequenzen", Vortrag auf dem Rehm Kundenforum am 22. Mai (2001), Zeitschrift Produktion von Leiterplatten und Systemen (PLUS) 08/2001, Eugen G. Leuze Verlag KG (2001).
- Peter Kersten und Wolfgang Schruttker, "Kleberlose Heatsink Verbunde, alternative Schaltungsträger in Leistungsbaugruppen", Elektronik Praxis, Leistungselektronik und Stromversorgung 05/2005 (März 2005).
- Peter Kersten and Juergen Krome, "On road testing of an electric vehicle under different driving conditions", Hybrid and Electric Vehicles, 9th Symposium, February 14th and 15th, Braunschweig (2012).

PUBLIKATIONEN VON PROF. DR. PETER KERSTEN

Stand: 10/2015

- Peter Kersten, "Anwendungsorientierte Lehre und Forschung: Methoden und Beispiele an der Hochschule Hamm-Lippstadt", Chinesisch-Deutsches Forum für Internationale Ausbildung (CDIA), Chongqing (2013).
- Peter Kersten und Birka von Schmidt, "Elektromobilität: Vom Technology Push zum Market Pull durch Vernetzung urbaner Lebensbereiche", 9. Symposium für Vorausschau und Technologieplanung, 5. und 6. Dezember 2013, Berlin (2013).
- Andrea Lemke, Peter Kersten und Thomas Ahrens, "Optimierung des Fertigungsprozesses Schablonendruck mit Hilfe der Design-of-Experiment-Methode", Zeitschrift Produktion von Leiterplatten und Systemen (PLUS) 09/2015, Eugen G. Leuze Verlag KG (2015).